



2020年12月期 決算説明資料

株式会社RS Technologies

2021年2月12日



東証1部
3445

目次

会社概要

P.3

会社概要
沿革
山東GRITEK 新工場竣工
中国子会社の上場準備開始について
中国子会社の上場準備の進捗状況
第3の成長エンジン：DGテクノロジーズの成長戦略
経営企画機能の拡充及び紺綬褒章受章
現在のRS Technologies
ウェーハ再生事業の地域別出荷数構成比

2020年12月期 決算概要

P.14

決算概要（累計）
セグメント及び会社別動向（累計）
営業利益増減要因分析（累計）
決算概要（10-12月）
セグメント及び会社別動向（10-12月）
セグメント動向 四半期業績グラフ
会社別動向 四半期業績グラフ
貸借対照表及びキャッシュフロー

中期経営計画（21年～24年）の見通し

P.23

中期経営計画（4か年）の概要
2021年12月期 決算見通し
設備投資計画：ウェーハ再生事業
設備投資計画：プライムウェーハ事業
中国投資計画（スケジュール）
中国投資計画（現在の進捗状況）
12インチウェーハ事業スキーム
ウェーハ再生事業の新規需要
再生ウェーハの需要見通し
RS Technologiesの目指す世界

Appendix

P.34

代表取締役 方永義の強み
ウェーハ再生ビジネス(1) (2)
プライムウェーハビジネスへの進出
中国における当社合弁相手について
山東省徳州市と提携：背景、経緯及び現状
中国事業への出資スキーム
業績推移
主要財務諸表
セグメント別 業績推移

1. 会社概要

会社概要

- ウェーハ再生で世界市場シェア3割の**トップ企業**※1。
- 中国中央政府直属企業との合併事業で**プライムウェーハ事業**にも本格進出。
- M&Aによりシナジーの期待できる**周辺事業領域**にも事業を拡大。

社名	株式会社RS Technologies
設立	2010年12月10日
経営理念	「地球環境を大切に、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」
事業内容	電子材料、電子機器部品、通信機器部品材料の製造、加工、再生、販売。太陽光発電事業。半導体関連設備の買取及び販売事業。半導体材料・パーツの販売。半導体シリコンウェーハ製造の技術コンサルティング。
本社所在地	東京都品川区大井1-47-1 NTビル 12F
三本木工場	宮城県大崎市三本木音無字山崎26-2
資本金	5,438百万円（2020年12月末時点）
代表取締役	方 永義
主な連結子会社	艾爾斯半導体股份有限公司（台湾） 資本金 NT \$300 million 出資比率 100%
	北京有研RS半導体科技有限公司（北京） 登録資本 US \$138 million 出資比率 45% ※2
	有研半導体材料有限公司（北京） 登録資本 8億人民元 出資比率 45% ※2
	株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューション 資本金 27百万円 出資比率 100%
	山東有研半導体材料有限公司（山東省徳州市） 登録資本 15億人民元 出資比率 36% ※2
	株式会社DG Technologies 資本金 100百万円 出資比率 100%

※1 SEMIデータに基づき弊社にて推計。

※2 中国事業における、連結対象となる出資スキームは、北京有研RS半導体科技有限公司を親会社として、有研半導体材料有限公司を子会社、山東有研半導体材料有限公司を孫会社としており、出資が一部重複しております。詳細は、P35「中国事業への出資スキーム」をご参照ください。

沿革

- ウェーハ再生事業で世界トップ。中国の大手プライムウェーハメーカーを連結子会社化、ウェーハ総合メーカーに。
- 2020年10月、山東省徳州市において、山東GRITEKの新工場が竣工、生産開始。

2010年（平成22年）12月	ウェーハ再生事業を主たる事業として株式会社RS Technologiesを設立
2011年（平成23年）1月	三本木工場において操業開始
2011年（平成23年）11月	三本木工場がUKASより「ISO9001:2008」（品質マネジメントシステム）認証取得
2013年（平成25年）10月	三本木工場においてソーラー事業を開始
2014年（平成26年）2月	台湾に子会社として艾爾斯半導體股份有限公司（現・連結子会社）を設立
2015年（平成27年）3月	東京証券取引所マザーズに株式を上場
2015年（平成27年）6月	最先端設備（18インチウェーハ再生可能）を導入した三本木工場・第8工場が竣工
2015年（平成27年）12月	艾爾斯半導體股份有限公司（現・連結子会社）の台南工場が竣工
2016年（平成28年）9月	東京証券取引所市場第一部（東証一部）へ市場変更
2017年（平成29年）12月	有研科技集団有限公司（GRINM）及び福建倉元投資有限公司と三社間で合併契約を締結
2018年（平成30年）1月	北京有研RS半導体科技有限公司（BGRS）を設立、中国プライムウェーハ製造メーカーである有研半導体材料有限公司（GRITEK）を連結子会社化
2018年（平成30年）5月	株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションの100%株式を取得(日立パワーデバイスの特約店)
2018年（平成30年）8月	山東有研半導体材料有限公司(GRITEKの連結子会社、山東GRITEK)を設立
2019年（平成31年）1月	株式会社DG Technologiesの100%株式を取得
2019年（令和元年）12月	GRINM、徳州滙達半導体股権投資基金パートナー企業及び山東省徳州市政府と四者間で合併契約を締結
2020年（令和2年）2月	上海悠年半导体有限公司（上海ユニオン）を設立
2020年（令和2年）3月	山東有研RS半導体材料有限公司（SGRS）並びに有研艾唯特（北京）科技有限公司（北京IVT）を設立
2020年（令和2年）10月	中国におけるプライムウェーハの生産拠点となる、山東GRITEKの新工場が竣工、生産開始

山東GRITEK 新工場竣工

- 2020年10月、山東省徳州市において、山東GRITEKの新工場が竣工。
- 中国におけるプライムウェーハの製造拠点として稼働開始。



中国子会社（GRITEK） 上場準備を開始

- 2020年9月、中国子会社（GRITEK）の上場準備を開始。
- 上場により、事業基盤を確立することで、更なる成長性を確保し、当社グループの企業価値の向上を図る。

上場の目的

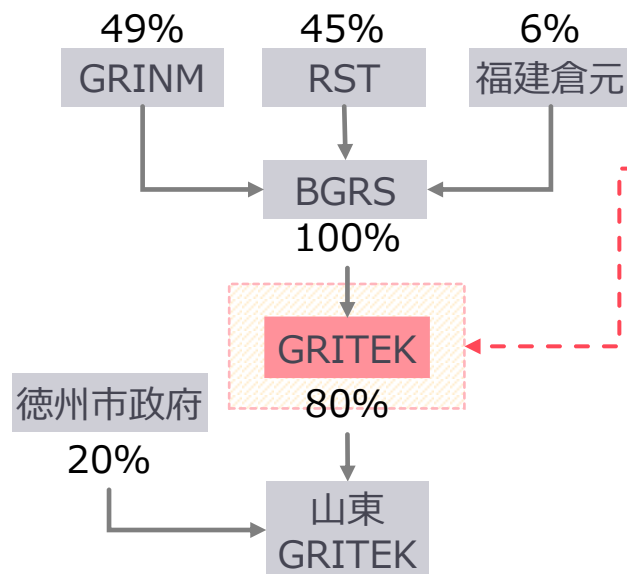
中国における事業基盤の確立

- ・資金調達手段の多様化
- ・ブランド力の向上
- ・優秀な人材の獲得

成長性の確保

- ・成長資金の確保
- ・営業力強化
- ・研究開発の促進及び生産性向上

当社グループの
企業価値向上



上場主体：GRITEK

- ・1999年設立、プライムウェーハの製造販売を営む
- ・2018年に当社グループの連結子会社化
- ・2020年の工場移転により、山東GRITEKへプライムウェーハの生産拠点を集約

上場予定市場：科创板市場（スターマーケット）

- ・中国版ナスダックと呼ばれる上海証券取引所の新興企業向け株式市場
- ・中国政府主導で開設され、2019年7月22日に取引開始
- ・他市場に比べ、収益性などの上場基準が緩和され、審査手続きも簡略化
- ・銘柄は新興ハイテク企業が中心
- ・当初25銘柄が上場し、1年間で130社超に拡大

中国子会社（GRITEK） 上場準備の進捗状況

- 中国子会社（GRITEK） 上場準備の一環として、BGRSが保有するGRITEK株式の一部譲渡を、2020年11月19日開催の取締役会において決議。
- 現在、上場準備中。

株式譲渡の概要

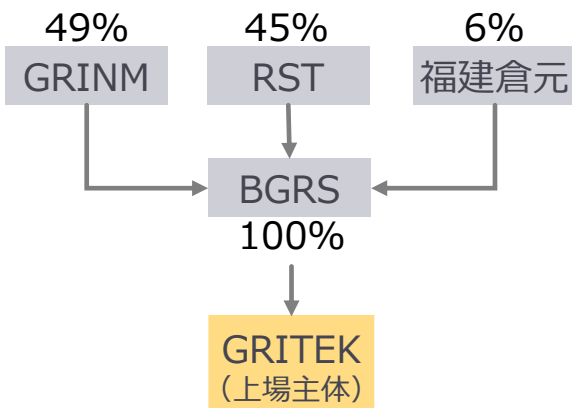
- ・譲渡前：BGRSは、GRITEK株式の100%を保有。
- ・譲渡内容：BGRSが保有するGRITEK株式を、GRINMへ25.60%、福建倉元へ3.14%、社員持株会へ5.00%、及び当社へ23.51%を譲渡。

株式譲渡の目的

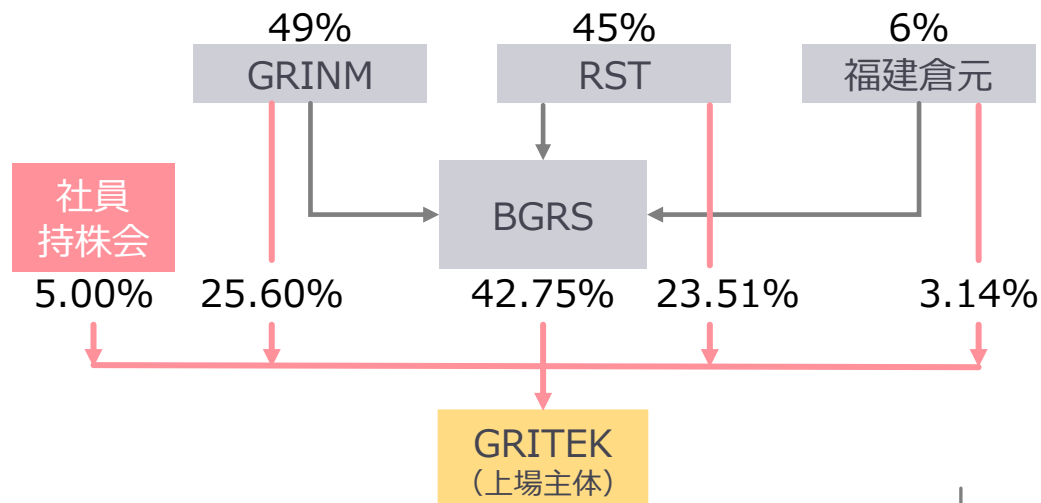
- ・従業員のモチベーションや帰属意識の向上
- ・中国国有機関であるGRINMとの良好な関係性の維持

↓
当社グループの企業価値向上

株式譲渡前



株式譲渡後



第3の成長エンジン：DGテクノロジーズの成長戦略（1/2）

- DGテクノロジーズは、大手半導体製造メーカーや半導体設備メーカーへ消耗部材を製造販売する部材メーカー。
- 2019年1月に、当社連結子会社化。

会社概要

DGtec 株式会社DGテクノロジーズ

社名	株式会社DG Technologies
設立	1981年10月26日
事業内容	半導体製造装置向けの消耗部材の製造・販売
所在地	茨城県神栖市砂山3-4
資本金	100,000千円
代表取締役	方 永義

製品

ドライエッチング装置向け
石英・シリコン製消耗部材



シリコン電極



石英リング

主な顧客

半導体製造メーカー
半導体設備メーカー 等

第3の成長エンジン：DGテクノロジーズの成長戦略（2/2）

- ドライエッチング装置向け部材市場は推定1500億円*1で今後も成長が見込まれる。
- RS既存ウェーハ顧客への営業とGRITEK仕入によるシナジー、及び、生産能力拡大と生産効率化による成長戦略を策定・実施。同市場におけるトップシェアを狙う。

市場の成長性

ドライエッチング装置向け
石英&シリコン消耗部材市場



約1,500億円
*1

ドライエッチング装置市場と
同程度の成長を期待

(先行指標)

ドライエッチング
装置市場



成長率
8% *2

成長戦略

- ◆ 営業活動の強化
RS既存ウェーハ顧客へのクロスセルを実施
- ◆ 生産能力の増強
設備投資を実施し、顧客の要求数量をタイムリーに生産・出荷する体制を構築（2021年に向けての設備投資額：約12億円）
- ◆ 生産効率の向上
生産能力増強と合わせて、人員・生産工程等の最適化を行い生産効率向上を図る
- ◆ 仕入の最適化
当社グループ会社のGRITEKより原材料仕入を行うことで、競争力強化を図る

経営企画機能の拡充及び紺綬褒章受章

- M&A等推進体制強化の一環として、経営企画室へ経験・ノウハウを持つ人員を増員。
- 2020年11月2日、これまでの大崎市への貢献や昨年度の企業版ふるさと納税等の功績が認められ、紺綬褒章を受章。

経営企画機能の拡充

部 署	経営企画室
人 数	3名（2021年2月12日現在）
業 務 内 容	M&A等の重要案件対応 グループ会社や他部門のサポート、他
組 織 上 の 位 置 づ け	代表取締役社長の直属部署

紺綬褒章の受章

- ・2020年11月2日、大崎市長より当社に褒状が伝達されました。
- ・紺綬褒章は、公益のため私財を寄付し、その功績が顕著な法人に対し、天皇陛下より授与されるものです。



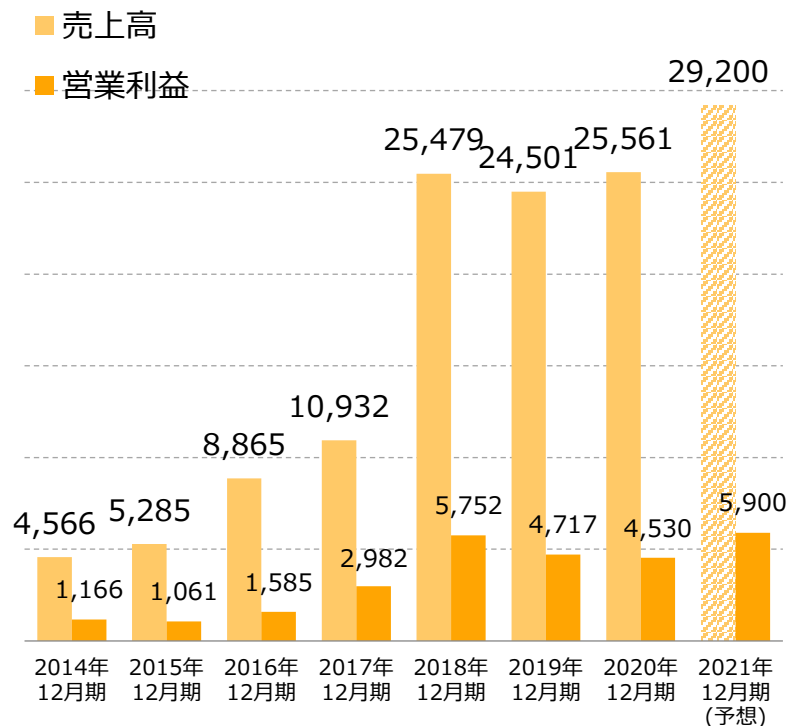
(2020年11月2日)

現在のRS Technologies

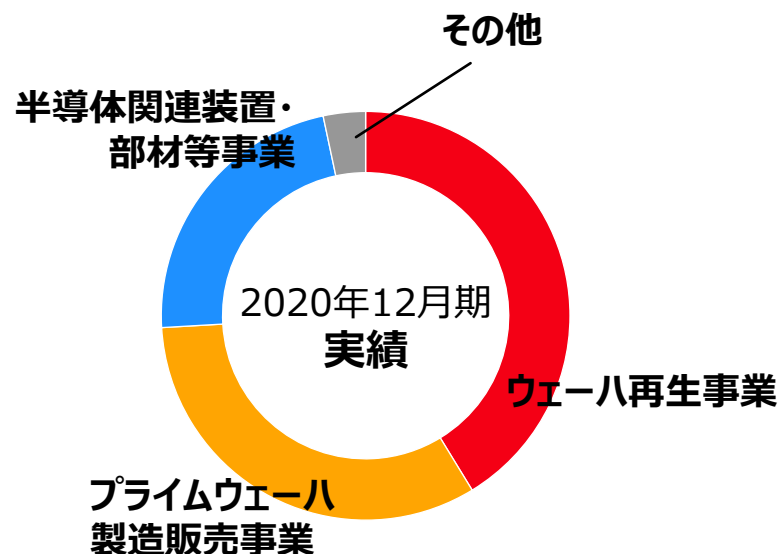
- ウェーハ再生事業 + プライムウェーハ事業の総合ウェーハメーカー。
- 半導体関連装置・部材等事業及びソーラー事業へも事業領域を拡大。
- ウェーハ再生事業はグローバルシェアNo1、プライムウェーハ事業では中国国内向けを中心に事業を展開。

連結売上高および営業利益

(百万円)

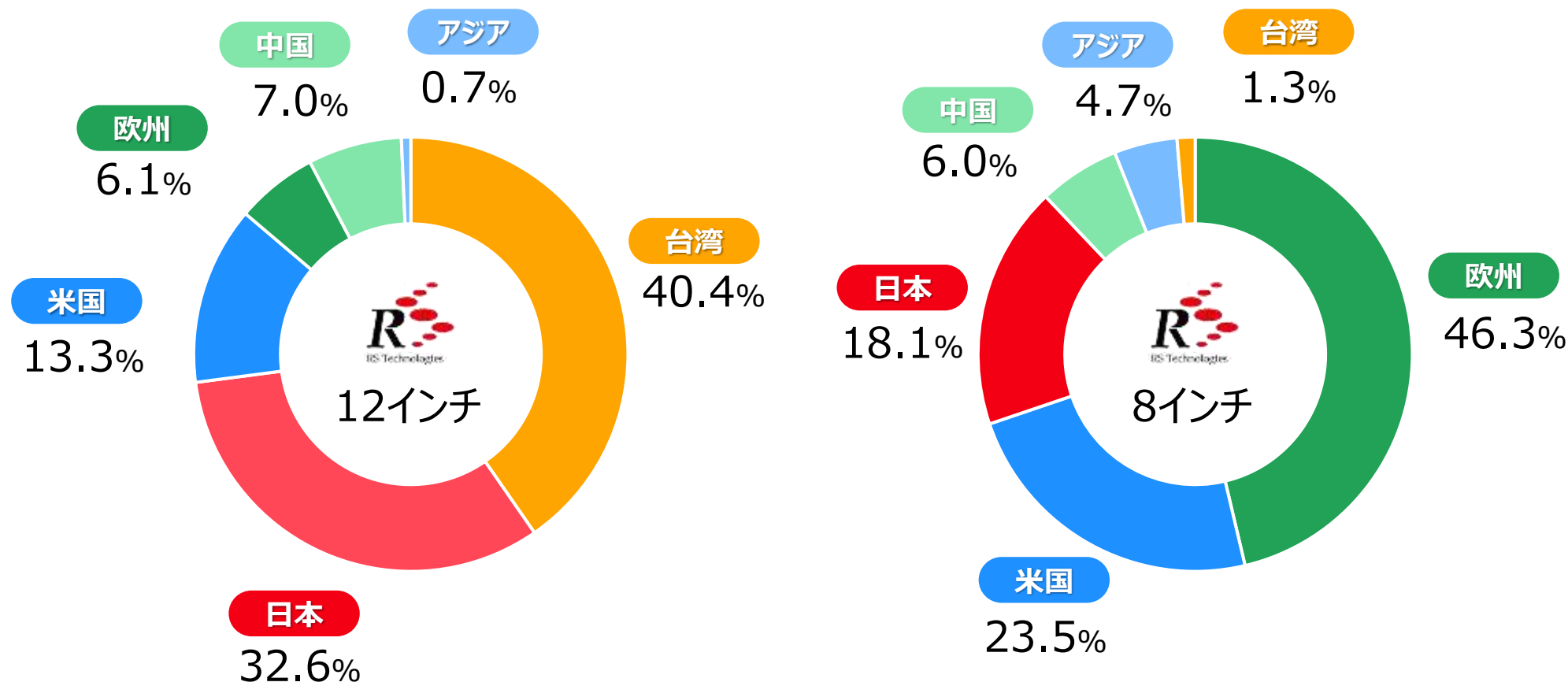


セグメント別売上高



ウェーハ再生事業の地域別出荷数構成比

- 日本、台湾、欧米を中心に、世界の主要な半導体メーカーを顧客としている。
- 2020年10月、山東GRITEKの新工場が竣工、今後の需要拡大に対応。



注：RST調べ、枚数ベース(2020年度)

2. 2020年12月期 決算概要

2020年12月期（累計） 決算概要

- 売上高は、ウェーハ再生事業及び半導体関連装置・部材等事業の寄与により、前期比増収。
- 営業利益は、プライムウェーハ事業における工場移転の影響により、前期比減益。

(百万円)	2019年12月期	2020年12月期 期初予想	2020年12月期 修正予想 2020年7月29日発表	2020年12月期	前期比	修正 予想比
売上高	24,501	22,700	23,500	25,561	4.3%	8.8%
営業利益	4,717	3,200	4,300	4,530	△4.0%	5.3%
営業利益率	19.3%	14.1%	18.3%	17.7%	△1.6pt	△0.6pt
経常利益	5,416	3,400	4,800	5,252	△3.0%	9.4%
経常利益率	22.1%	15.0%	20.4%	20.5%	△1.6pt	0.1pt
親会社株主に 帰属する 当期純利益	3,035	2,400	2,800	2,824	△7.0%	0.9%
一株当たり 当期純利益	236.98	187.07	216.74	219.15	△7.5%	1.1%

2020年12月期（累計） セグメント及び会社別動向

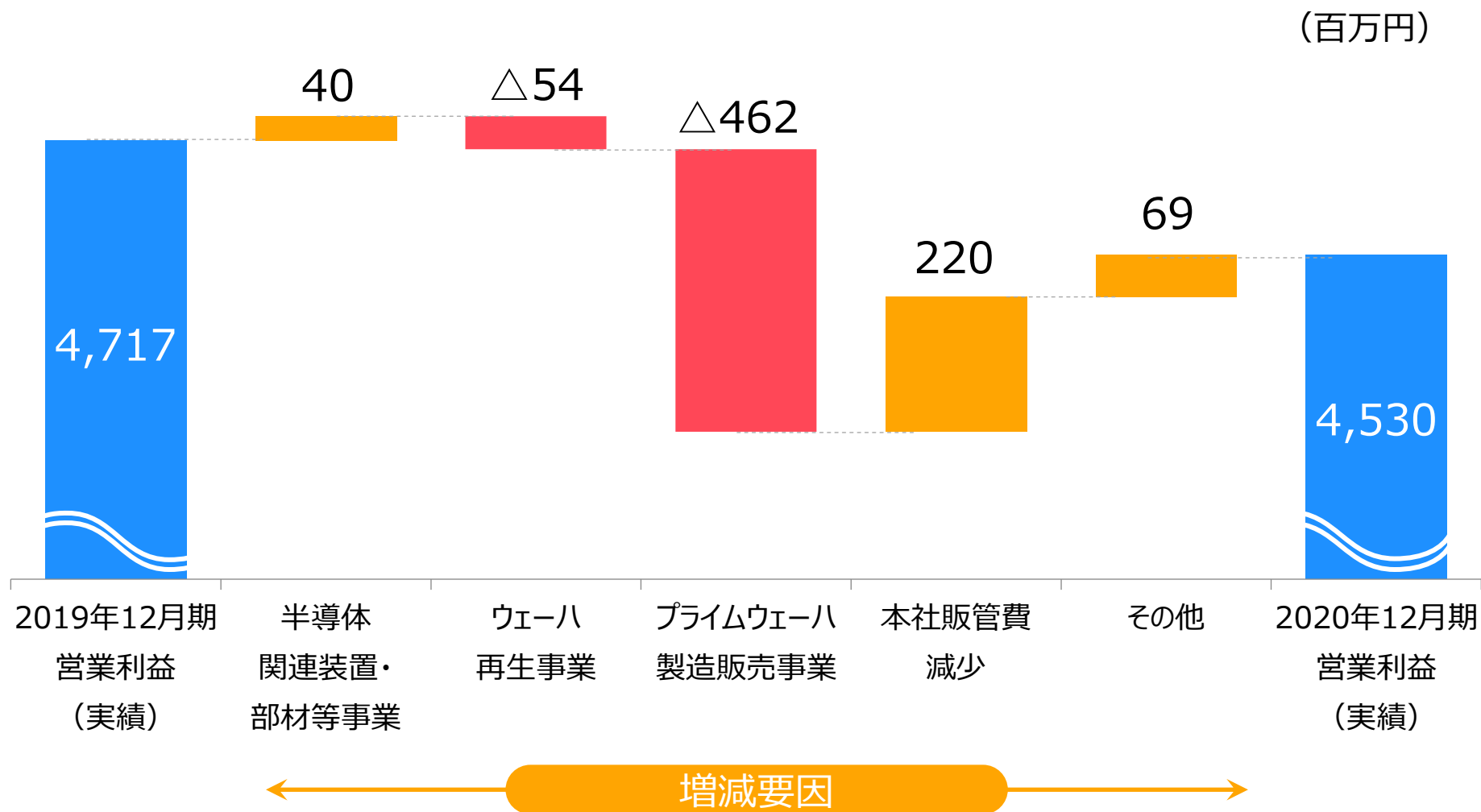
- ウェーハ再生事業は、設備投資による生産能力増加により前期比増収。営業利益はCOVID-19による輸送費等の増加により前期比微減。
- プライムウェーハ事業は、COVID-19及び工場移転の影響により前期比減収。営業利益は、新工場への移転費用等により前期比減益。
- 半導体関連装置・部材等事業は、営業体制強化等による販売増加で、前期比増収増益。

セグメント別 (百万円)	ウェーハ再生事業		プライムウェーハ 製造販売事業		半導体関連装置・ 部材等事業		その他、調整額		連結合計	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
売上高	11,461	6.4%	8,755	△13.0%	6,272	55.0%	△927	-	25,561	4.3%
営業利益	4,027	△1.3%	1,041	△30.7%	211	23.4%	△749	-	4,530	△4.0%
営業利益率	35.1	△2.8pt	11.9	△3.1pt	3.4	△0.9Pt	-	-	17.7	△1.6pt

会社別 (百万円)	RS		台湾子会社		中国子会社		その他、調整額		連結合計	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
売上高	11,532	22.1%	4,842	39.8%	8,783	△12.7%	404	-	25,561	4.3%
営業利益	2,107	5.9%	1,425	20.3%	725	△53.6%	273	-	4,530	△4.0%
営業利益率	18.3	△2.8pt	29.4	△4.8Pt	8.3	△7.3pt	-	-	17.7	△1.6Pt

2020年12月期（累計） 営業利益増減要因分析

- 半導体関連装置・部材等事業は前期比増益も、プライムウェーハ事業における工場移転の影響から、連結は前期比減益。



2020年12月期第4四半期（10-12月）決算概況

- 売上高は、半導体関連装置・部材等事業及びウェーハ再生事業が寄与し、前年同期比増収。
- 営業利益は、主にプライムウェーハ事業における新工場への移転費用等により、前年同期比減益。

(百万円)	2019年12月期 第4四半期	2020年12月期 第4四半期	前年同期比	差額
売上高	5,882	6,562	11.6%	680
営業利益	971	628	△35.3%	△343
営業利益率	16.5%	9.6%		△6.9Pt
経常利益	1,106	1,070	△3.3%	△36
経常利益率	18.8%	16.3%		△2.5Pt
親会社株主に帰属する 当期純利益	528	494	△6.4%	△34
一株当たり当期純利益	41.24円	38.19円	△7.4%	△3.05円

2020年12月期第4四半期（10-12月）セグメント及び会社別動向

- ウェーハ再生事業は、顧客需要の増加により前期比増収。営業利益は、輸送費等の増加により前期比減益。
- プライムウェーハ事業は、工場移転の影響から前期比減収。営業利益は、移転費用等※により前期比減益。
- 半導体関連装置・部材等事業は、営業体制強化等による販売増加で、前期比増収増益。

※移転費用等は主に新工場への移転費用であり、中国政府より補助金を受領しています。

会計処理上は、営業外収益に補助金収入を計上しているため、営業利益は低下していますが、経常利益は費用と補助金収入の相殺後の水準となります。

セグメント別 (百万円)	ウェーハ再生事業		プライムウェーハ 製造販売事業		半導体関連装置・ 部材等事業		その他、調整額		連結合計	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
売上高	3,044	4.7%	1,753	△17.2%	2,018	103.0%	△253	-	6,562	11.6%
営業利益	954	△19.4%	△331	-%	97	47.0%	△92	-	628	△35.3%
営業利益率	31.3	△9.3Pt	△18.9	△18.0Pt	4.8	△1.8Pt	-	-	9.6	△6.9pt

会社別 (百万円)	RS		台湾子会社		中国子会社		その他、調整額		連結合計	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
売上高	3,417	46.7%	1,337	32.9%	1,799	△15.0%	9	-	6,562	11.6%
営業利益	622	9.9%	367	△7.3%	△719	-%	358	-	628	△35.3%
営業利益率	18.2	△6.1Pt	27.4	△11.9pt	△40.0	△39.6pt	-	-	9.6	△6.9pt

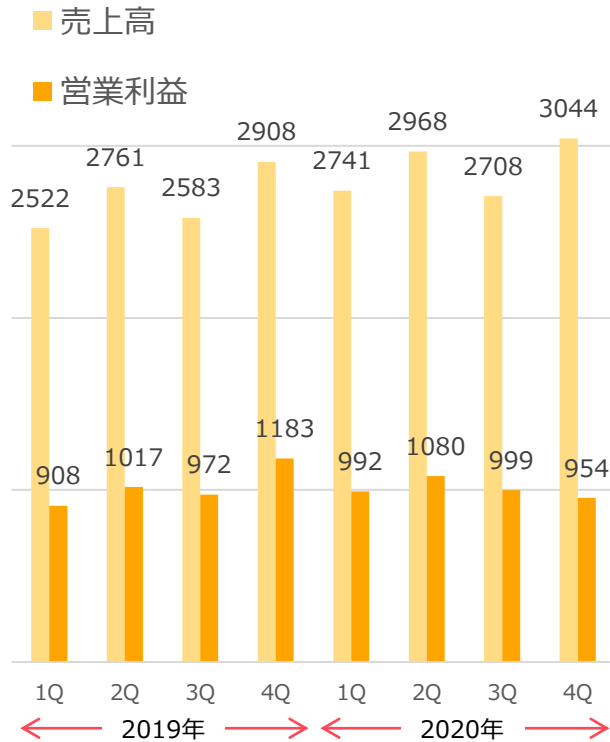
2020年12月期第4四半期 セグメント動向 四半期実績グラフ

- ウェーハ再生事業は、顧客の強い需要を背景に、引き続き堅調な推移。
- プライムウェーハ事業は、工場移転の影響による短期的な減収局面。営業利益は、移転費用等※により減益。
- 半導体関連設備・部材等事業は、営業体制強化等による販売増加で、前四半期比増収増益。

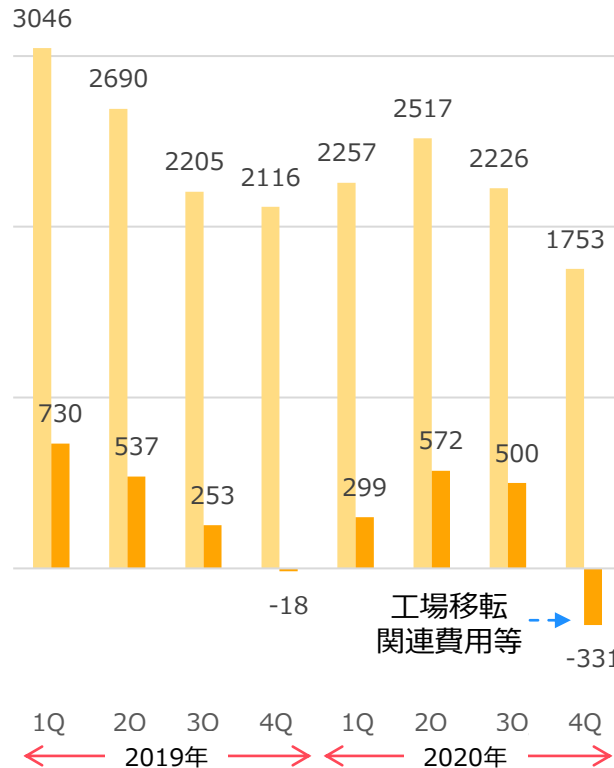
※移転費用等は主に新工場への移転費用であり、中国政府より補助金を受領しています。

会計処理上は、営業外収益に補助金収入を計上しているため、営業利益は低下していますが、経常利益は費用と補助金収入の相殺後の水準となります。

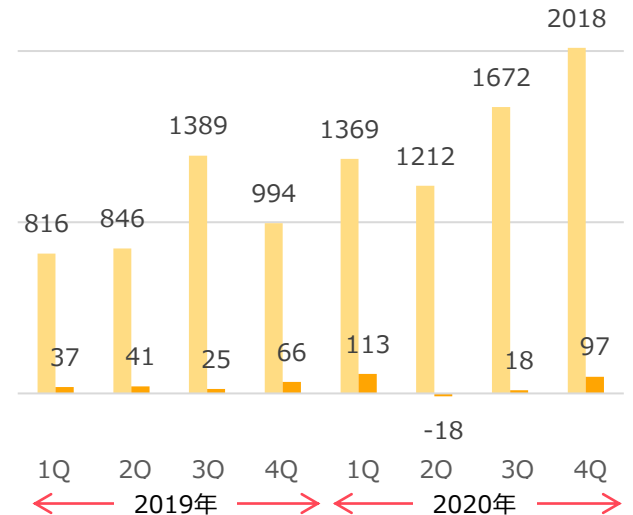
ウェーハ再生事業



プライムウェーハ事業



半導体関連装置・部材等



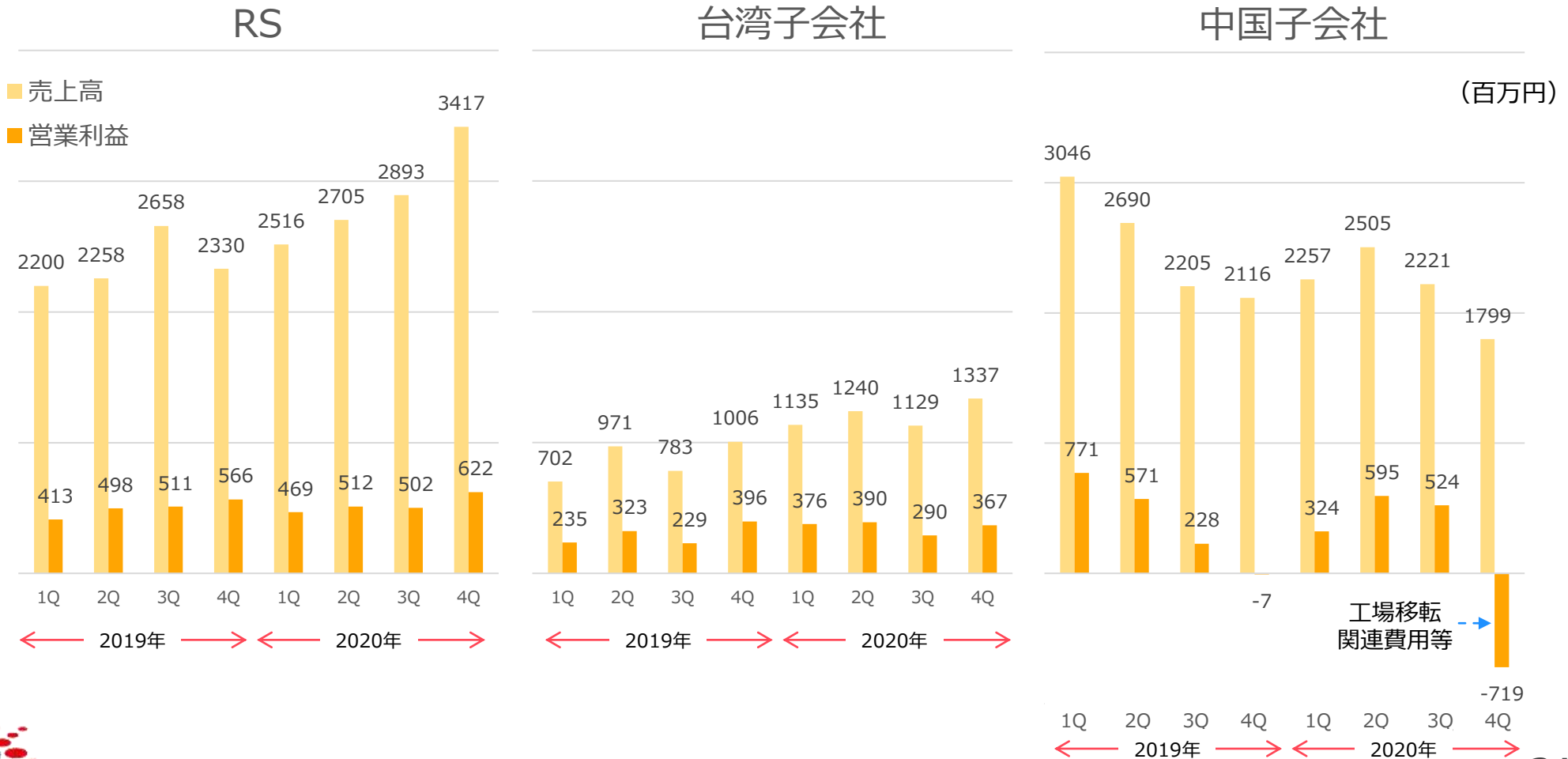
(百万円)

2020年12月期第4四半期 会社別動向 四半期実績グラフ

- RSは、ウェーハ再生事業が堅調な中、営業体制強化等により半導体関連装置・部材の販売が増加。
- 台湾子会社は、引き続き顧客需要が強く、堅調な推移。
- 中国子会社は、工場移転の影響による短期的な減収局面。営業利益は、移転費用等※により減益。

※移転費用等は主に新工場への移転費用であり、中国政府より補助金を受領しています。

会計処理上は、営業外収益に補助金収入を計上しているため、営業利益は低下していますが、経常利益は費用と補助金収入の相殺後の水準となります。



貸借対照表及びキャッシュフロー

- 投資活動によるキャッシュフローは、徳州市の新工場関連投資の実行等により、91億円のキャッシュアウト。
- 現金及び現金同等物の増減額は、新工場投資等により、34億円の減少。

連結貸借対照表

(百万円)	2019年12月期	2020年12月期
資産の部		
流動資産	32,760	32,626
現金及び預金	22,156	19,082
受取手形及び売掛金	6,047	6,321
商品及び製品	1,713	2,116
固定資産	15,873	26,124
有形固定資産	14,635	24,146
無形固定資産	732	527
投資その他資産	506	1,451
資産合計	48,634	58,750
負債の部		
流動負債	7,252	12,631
支払手形及び買掛金	1,614	2,871
有利子負債	1,730	1,522
固定負債	5,400	5,754
長期借入金	2,232	1,613
負債合計	12,652	18,385
純資産	35,981	40,365
負債・純資産合計	48,634	58,750

キャッシュ・フロー

(百万円)	2019年12月期	2020年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,015	6,377
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,107	△9,188
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,206	△776
現金及び現金同等物に係る換算差額	△404	134
現金及び現金同等物の増減額	6,710	△3,453
現金及び現金同等物の期首残高	14,652	21,363
現金及び現金同等物の期末残高	21,363	17,910

3. 中期経営計画の見通し

中期経営計画（4か年）の概要

- ウェーハ再生事業は、需要の拡大を想定した投資を実施し、堅調な推移を想定。
- 8インチプライムウェーハ事業は、安定生産期へ移行し、増産が寄与。
- 半導体関連装置・部材等事業は、中国での新市場開拓やグループシナジーの活用による成長戦略を実施。

	2020年 12月期	2021年 12月期	2022年 12月期	2023年 12月期	2024年 12月期
	実績	計画	計画	計画	計画
売上高	25,561	29,200	32,900	34,800	37,100
営業利益	4,530	5,900	6,500	7,000	7,900
営業利益率	17.7%	20.2%	19.8%	20.1%	21.3%
経常利益	5,252	5,900	6,600	7,100	8,000
経常利益率	20.5%	20.2%	20.1%	20.4%	21.6%
親会社株主に帰属 する当期純利益	2,824	3,100	3,700	4,200	4,800
一株当たり 当期純利益	219.15	240.51	286.19	324.87	371.27

2021年12月期 決算見通し

- RS及び台湾子会社は、設備投資による減価償却費の増加等により前期比減益を見込むものの、プライムウェーハ事業における新工場の生産拡大や、半導体関連装置・部材等事業の更なる売上増加により、連結では前期比増収増益を想定。

(百万円)	2020年12月期 (2020年1月～12月)	2021年12月期 (2021年1月～12月)	前期比	
	通期実績	通期予想	増減	増減率
売上高	25,561	29,200	3,639	14.2%
営業利益	4,530	5,900	1,370	30.2%
営業利益率	17.7%	20.2%	2.5pt	
経常利益	5,252	5,900	648	12.3%
経常利益率	20.5%	20.2%	△0.3pt	
親会社株主に帰属する当期純利益	2,824	3,100	276	9.8%
一株当たり当期純利益	219.15円	240.51円	21.36	9.7%
年間配当金	20円	20円	-	-

(百万円)	RS		台湾子会社		中国子会社		その他、調整額	連結合計	
		前期比		前期比		前期比			前期比
売上高	11,300	△2.0%	4,900	1.2%	10,900	8.4%	2,100	29,200	14.2%
営業利益	1,700	△19.3%	1,200	△15.8%	2,600	66.2%	400	5,900	30.2%
営業利益率	15.0%	△3.3pt	24.5%	△4.9pt	23.9%	8.4pt	-	20.2%	2.5pt

設備投資計画：ウェーハ再生事業

■世界の半導体需要が拡大する中、日本・台湾での増産、及び、中国山東省において量産開始。

日本

総投資額： 14億円

- 12インチ再生ウェーハの生産能力拡充
- 2021～2022年：14億円(4万枚)

12インチ再生ウェーハ生産能力（月産）

2020年	2021年	2022年	2023年
26万枚	28万枚	30万枚	30万枚

2021年度	2022年度	2023年度
9億円	5億円	未定

台湾

総投資額： 14億円

- 12インチ再生ウェーハの生産能力拡充及び微細化対応
- 2021～2023年：14億円(4万枚)

12インチ再生ウェーハ生産能力（月産）

2020年	2021年	2022年	2023年
16万枚	18万枚	19万枚	20万枚

2021年度	2022年度	2023年度
8億円	3億円	3億円

中国

総投資額： 36億円

- 12インチ再生ウェーハ生産拠点の新設投資
- 第1期投資(2021～2023年)：36億円(5万枚)
- 第2期投資(2024年～)：投資額未定（5万枚）

12インチ再生ウェーハ生産能力（月産）

2020年	2021年	2022年	2023年
0万枚	0万枚	5万枚	5万枚

第1期投資

2021年度	2022年度	2023年度
30億円	5億円	1億円

設備投資計画：プライムウェーハ事業

- 8インチプライムウェーハは、新工場の早期立ち上げを実施し、月産13万枚での安定した量産体制の構築を目指す。
- 12インチプライムウェーハは、月産1万枚のテストラインを設置し、量産化研究開発を進める。

中国 8インチ

- 新工場の早期立ち上げ
- 安定した量産体制の構築を目指す

8インチプライムウェーハ生産能力（月産）

2020年 → 2021年
8万枚 → **13**万枚

2021年度	2022年度	2023年度
—※1	未定	未定

※1 2020年度までに投資済み

中国 12インチ

テストライン投資額： 40億円

- 12インチプライムウェーハ量産化のための研究開発
- 1万枚のテストラインを経て、30万枚の量産体制を目指す

12インチプライムウェーハ生産能力（月産）

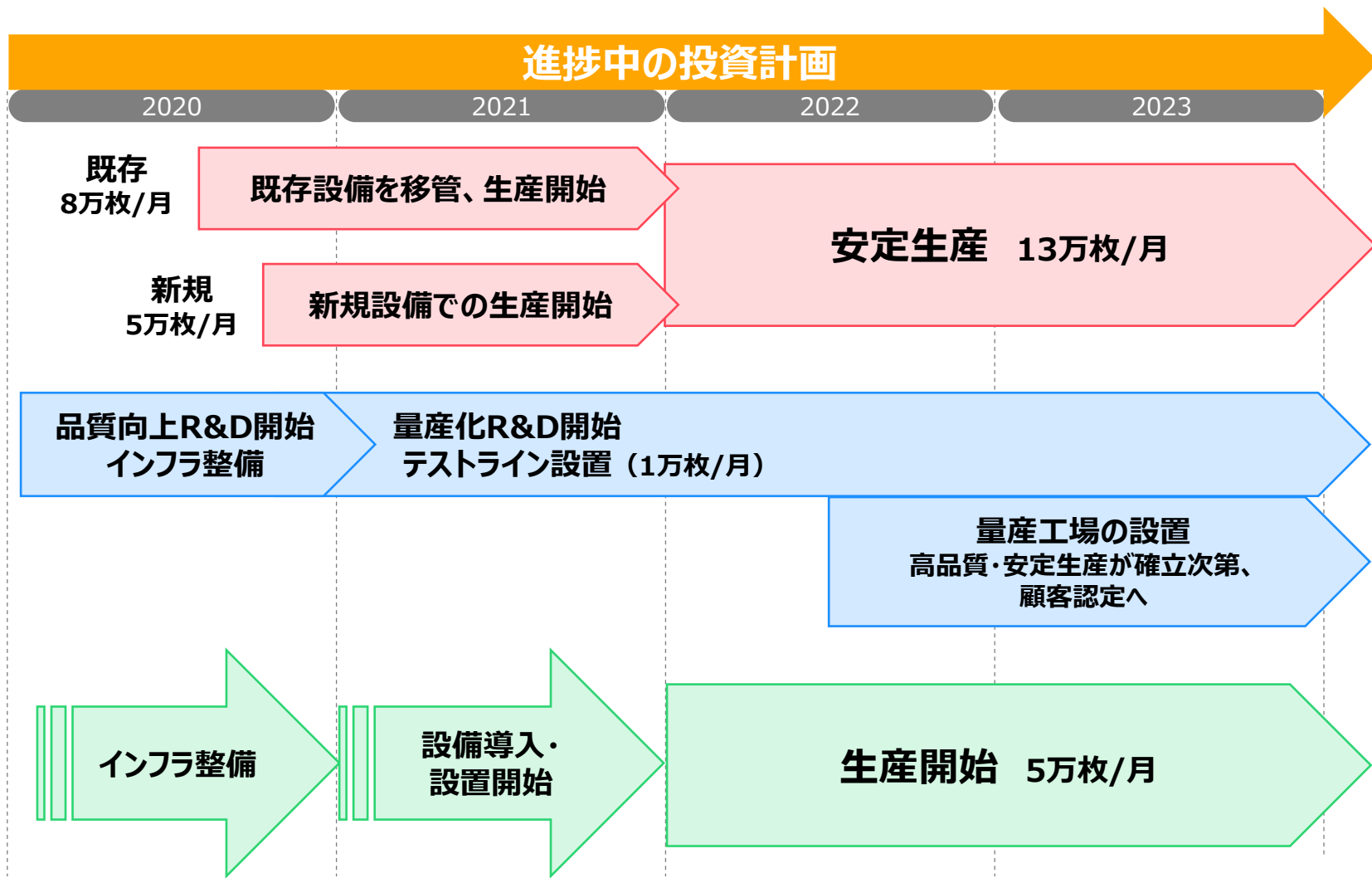
2020年 → 2021年 → 202X年
0万枚 → **1**万枚※2 → **30**万枚

2021年度	2022年度	2023年度
40億円	未定	未定

※2 量産化研究開発のためのテストライン

中国投資計画（スケジュール）

- 8インチ月産13万枚の安定生産、及び、12インチの月産1万枚のテストラインの設置による量産化研究開発、ウェーハ再生事業の立上げを並行して実施。12インチは高品質化・安定生産を早期に目指す。



中国投資計画（現在の進捗状況）

- 8インチプライムウェーハ新工場が2020年に竣工、量産を開始。
- 12インチプライムウェーハの量産化に向けた研究開発では、インゴットの品質改善を実施中。

8インチプライムウェーハの進捗状況 (2020年10月16日 竣工)



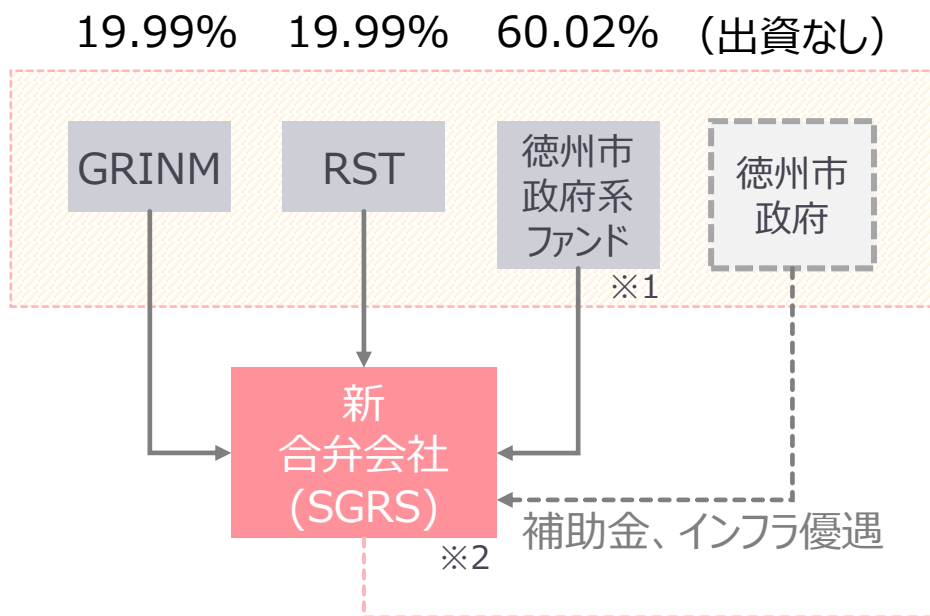
12インチプライムウェーハの進捗状況 (2020年5月29日撮影 12インチ インゴット)



中国における12インチシリコンウェーハ事業スキーム

- 徳州市政府等と共同で新たな合併会社を2020年3月に設立。
- 12インチシリコンウェーハ事業へ参入も、当初の出資比率を押さえることで初期リスクを抑制。
- 1万枚/月のテストラインを経て、30万枚/月の量産体制を目指す。

合併会社の出資スキーム



合併契約

- ・合併契約は4者間で締結。
- ・出資は3者（GRINM、RST、徳州政府ファンド）
- ・徳州市政府はインフラ等のサポートを提供。

事業内容

- ・12インチプライムウェーハ事業(生産、販売、開発)
- ・12インチウェーハ再生事業

※1 徳州滙達半導体股権投資基金パートナー企業

※2 山東有研RS半導体材料有限公司

ウェーハ再生事業の新規需要：12インチ半導体新工場

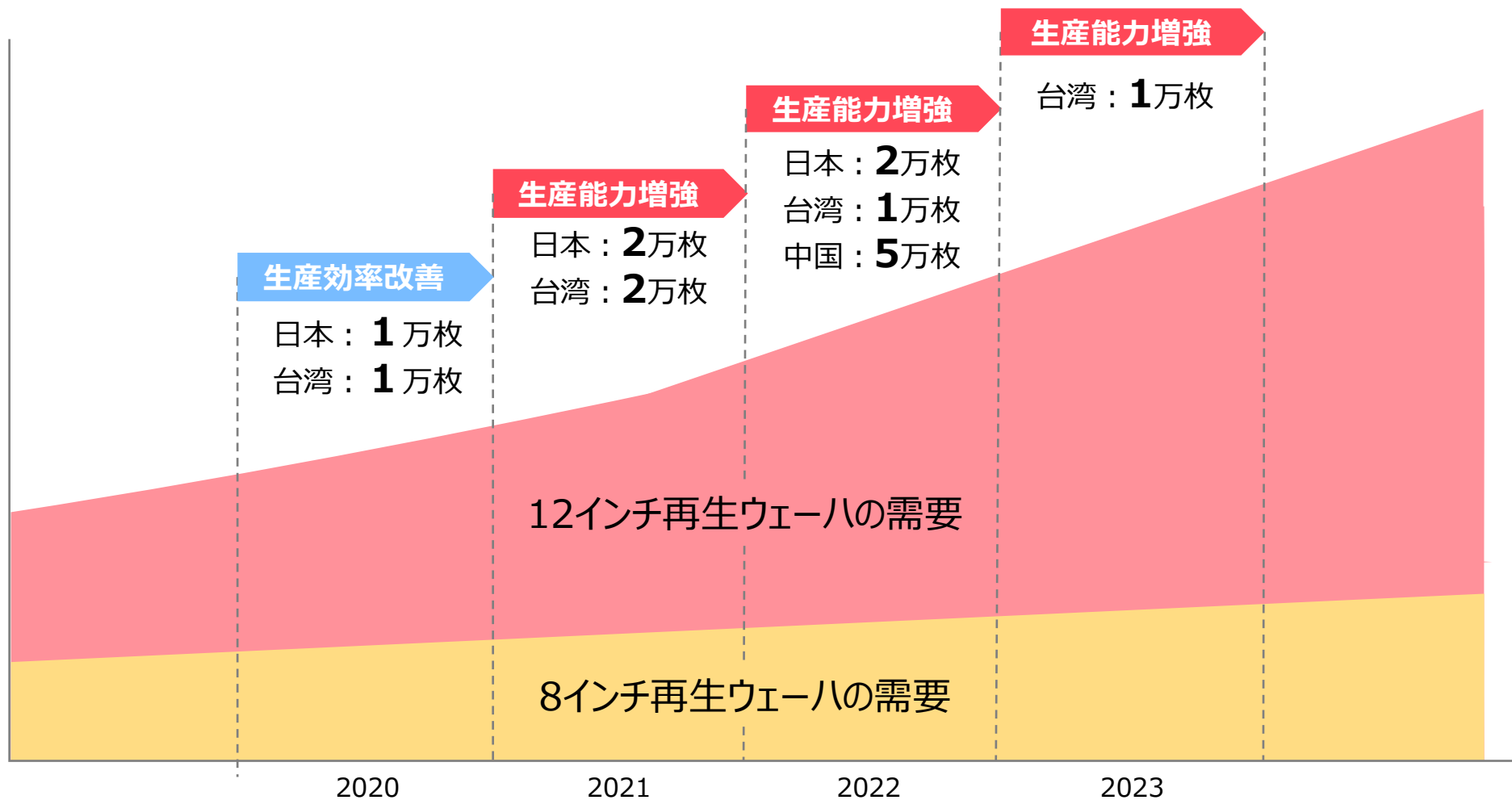
- 中欧米日等でメモリー・CPU・自動車の電子化等による旺盛な半導体需要に対応した、12インチ半導体新工場が建設中。
- 日本、台湾及び中国への設備投資により、新たな再生ウェーハ需要へ対応。



注：RST調べ

再生ウェーハ需要の見通し：12インチ中心に拡大続く

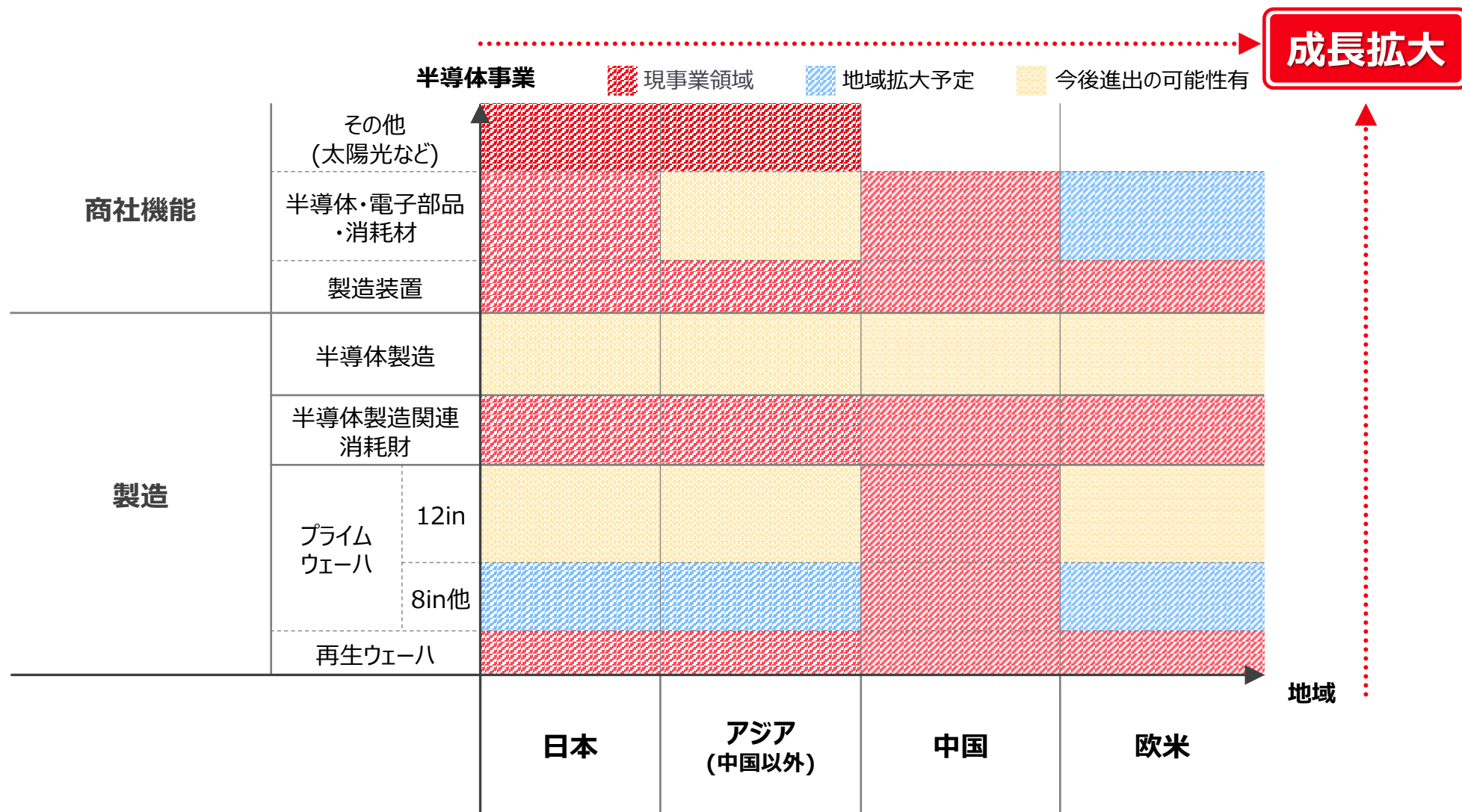
- 拡大する再生ウェーハ需要に対応し、2021～2023年に日本で4万枚、台湾で4万枚、中国で5万枚の生産能力増強を予定。



注：RST調べ

RS Technologiesの目指す世界

- 一步一步、着実に事業領域および販売地域を広げていく。



Appendix

代表取締役 方永義の強み

- 代表取締役社長である方永義が20年以上にわたって日本で培った知見と自身が持つネットワークを生かした全世界への販売力・人脈力・提携力・資金力が強み。
- 方永義の下にハイテクや金融など幅広い分野のプロフェッショナル人財が集結。



方永義は 前列中央（2016年9月、東京証券取引所にて撮影）

方 永義（ほう ながよし）

1970年生まれ 中国福建省出身
城西国際大学院 修了

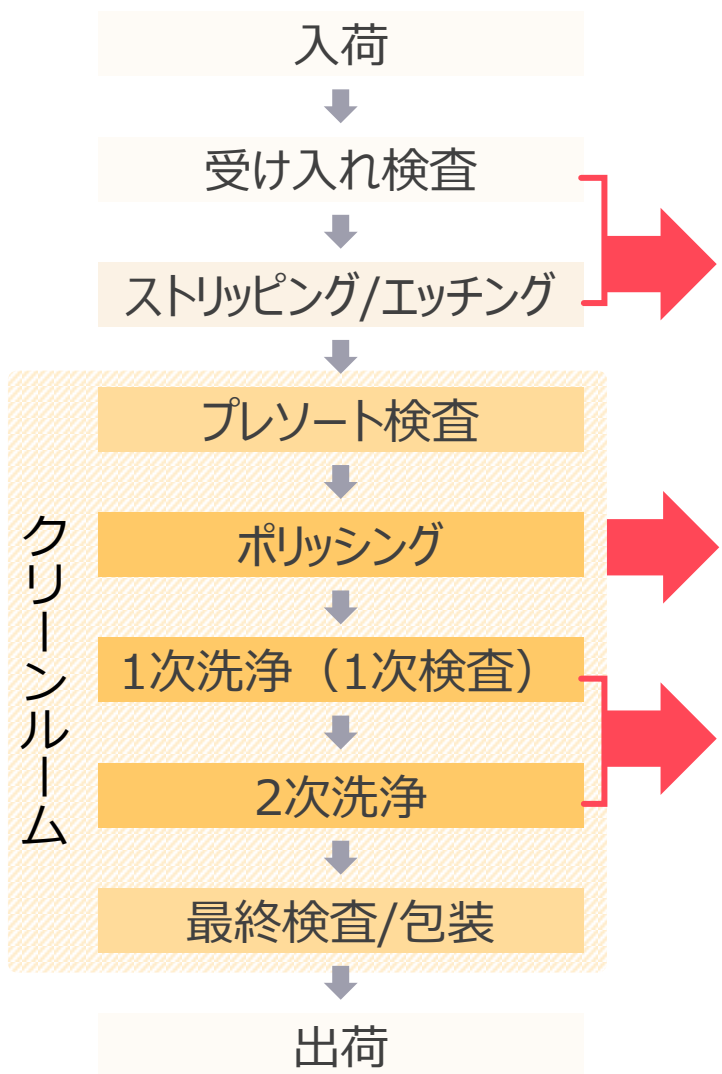
得意分野：
M & A、業務提携（過去10社を超えるM & Aを成功）

1998年 永輝商事設立
2010年 当社設立社長就任（現任）

大切にしている心：為せば成る

補足：

高校卒業後に来日。日本国内外で20以上の会社の投資経験。「半導体事業」の他、ファンドや貿易、ホテル、IT事業、農業等様々な業界の投資を経験。「日本のものづくりは世界一」との信条の元、それを世界に広めていくため、世界中を飛び回っている。



強み 1

すべての膜を剥離可能

- ケミカルによる除去の為、表面のダメージが最小限に

▶ 再生回数が多い ▶ よりコストダウンが可能

ラサ工業（化学）の特異技術を継承



表面に付いているキズや凹凸を研磨（ポリッシング）により平滑にする

強み 2

金属不純物を除去

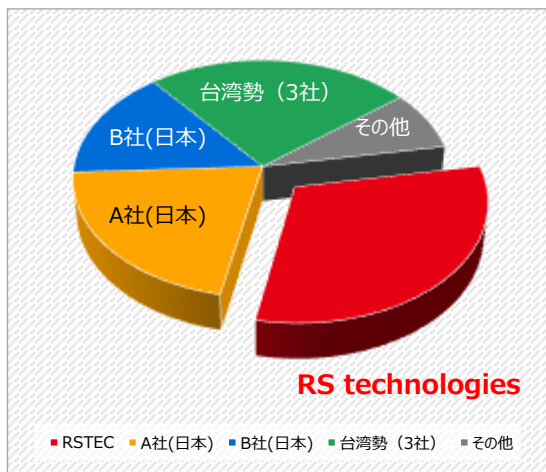
- ウェーハ表面の微細ゴミ・汚れを洗浄で取り除く
- + 金属不純物を除去 特に銅 (Cu) の除染除去に強み



再生ウェーハビジネス(2)

再生市場での当社のシェア拡大

12インチ再生市場における当社シェア



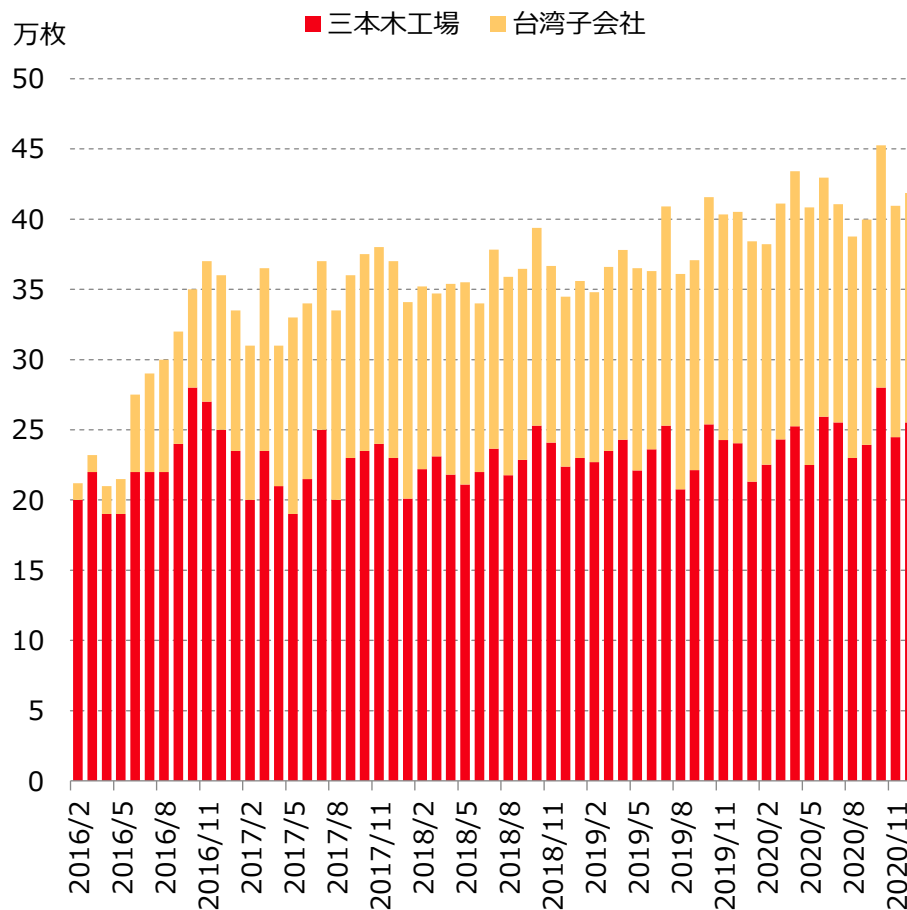
注：RST調べ

	2015 年上期	2015 年下期	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
当社グループ 生産能力	18万枚	24万枚	28万枚	30万枚	34万枚	40万枚	42万枚
当社グループ シェア	19%	24%	29%	30%	31%	33%	33%

注：RST調べ

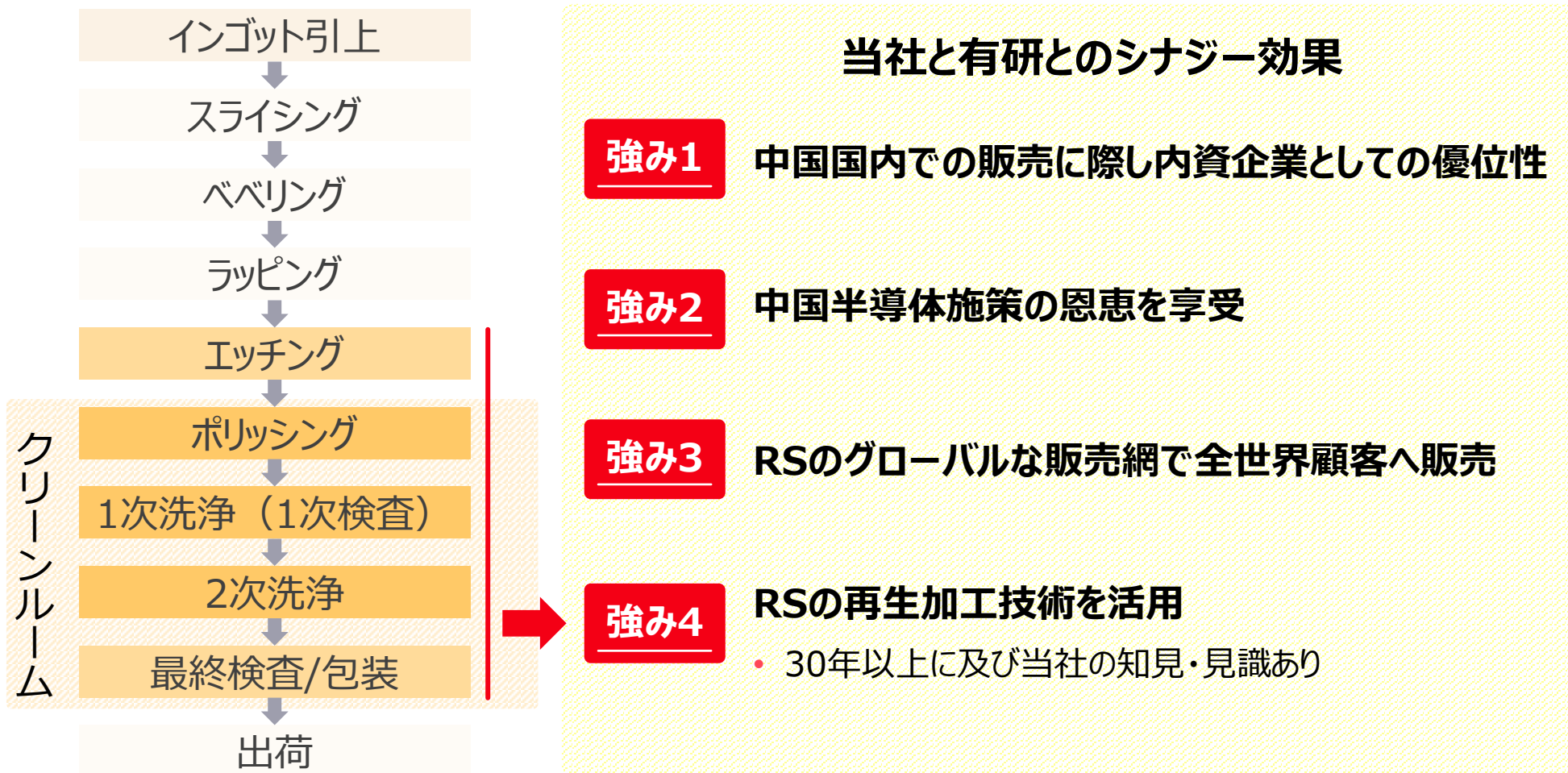
三本木工場と台湾子会社の出荷推移 (2016年-2020年)

三本木工場と台湾子会社の12インチウェーハ出荷枚数推移



プライムウェーハビジネスに進出

- 中国中央政府直属企業の北京有色金属研究総院（現 有研科技集团有限公司）との合併会社を設立。内資企業（中国の国内企業）として半導体事業を推進



中国における当社合併相手について

- 1952年創立。**中国の非鉄金属分野で最大の国有研究機関。**
- 中国の企業数約1,300万社のうち、国有企業は30万社。
その内、中央政府直属企業は88社であり、GRINMはその中の1社。
- 政府・産業・学問が一体化した研究機関で、中央政府の非鉄金属分野における方針は当該会社を通して発信される。
- 研究の成果物として、事業会社を設立。現在、その数は34社にも及ぶ。
- 当社との合併会社である北京有研RS半導体科技有限公司（BGRS）の傘下に入るGRITEKは2001年事業会社第1号として設立された。



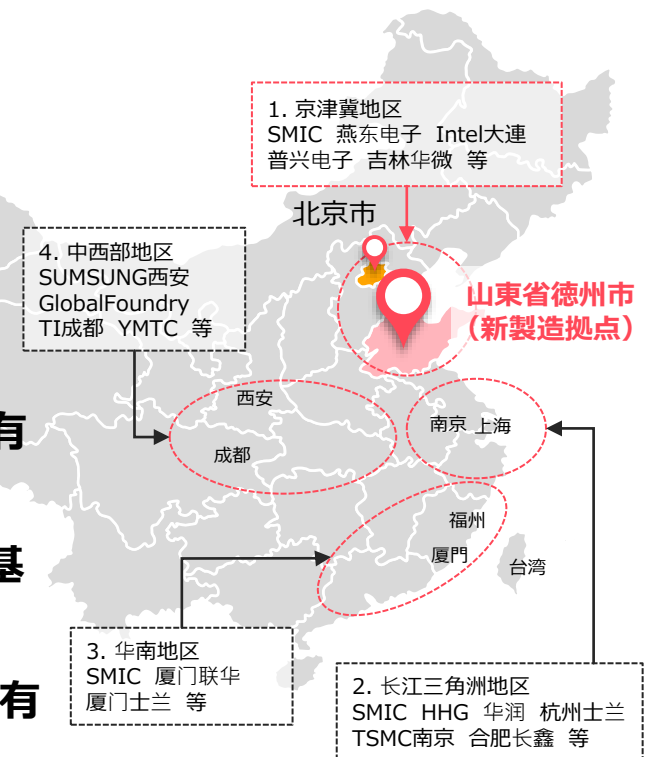
徳州市との提携：背景、経緯及び現状（山東GRITEK新工場竣工）

提携の背景

1. 周辺に世界的な主要半導体メーカーの工場誘致が進み、半導体メーカーの集積地に近い好立地であること（右図参照）
2. 水道光熱費の低減や安価な社宅の提供といった福利厚生面が充実していること
3. 理工系大学が近隣にあり、優秀な人材獲得の面で優位性があること
4. 最大約50万㎡（当初は20万㎡）まで拡張可能な敷地により今後の中国事業推進に十分対応できる用地が確保されていること

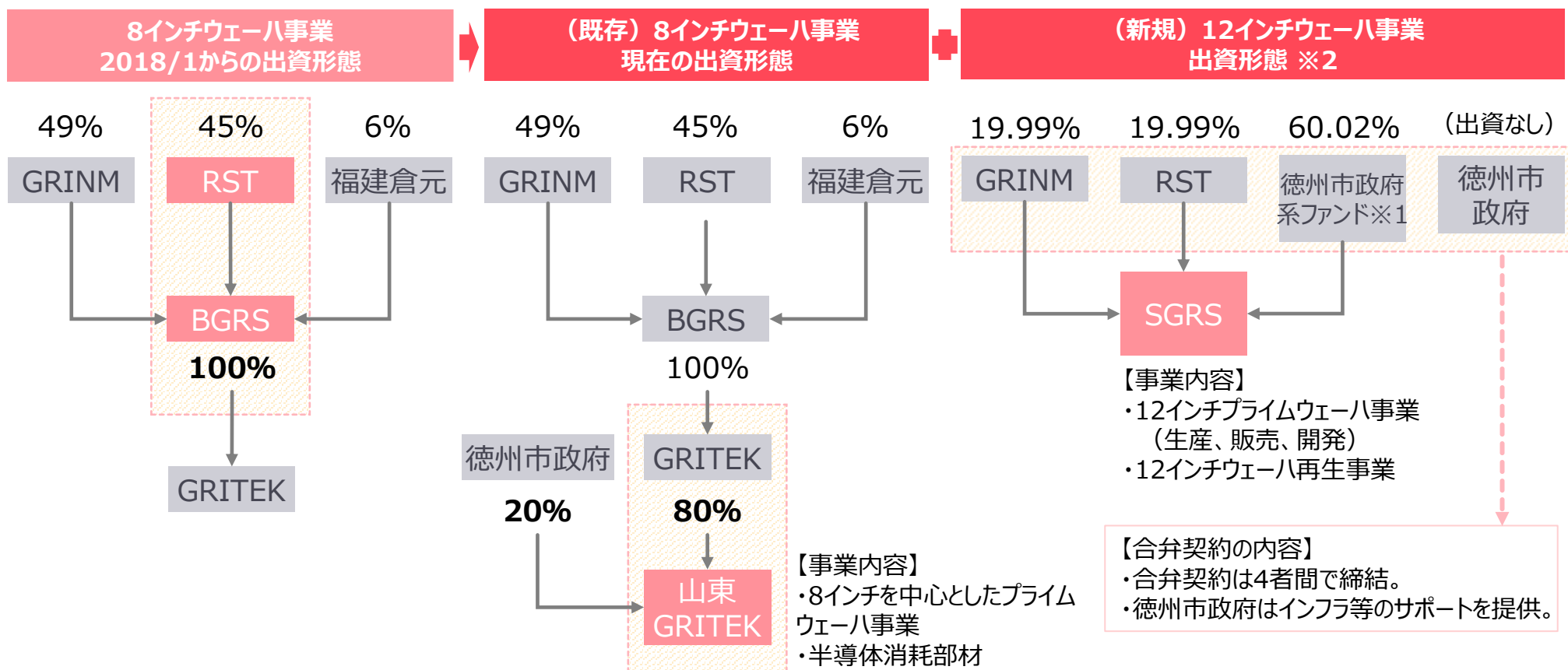
経緯及び現状

1. 2018年8月23日に8インチウェーハビジネスを手掛ける新会社（山東有研半導体材料有限公司）設立
2. 2019年12月に有研科技集团有限公司、徳州滙達半導体股権投資基金パートナー企業及び山東省徳州市政府と四者間で合併契約を締結
3. 2020年3月に12インチウェーハビジネスを手掛ける新合併会社（山東有研RS半導体材料有限公司）を設立
4. 2020年10月16に徳州市の新工場竣工式を実施



中国事業への出資スキーム

- 新たに12インチウェーハ事業を手掛けるため、GRINM、徳州市政府等と共同で新たに合併会社（山東有研RS半導体材料有限公司：SGRS）を設立。当初の出資比率を押さえることにより、初期リスクを抑制。
- 新合併会社で手掛けるプライムウェーハ事業では、1万枚/月のテストラインを経て30万枚/月の量産体制を目指す。また、ウェーハ再生事業では、第1期投資として5万枚/月の稼働を目指す。



※1 徳州滙達半導体股権投資基金パートナー企業

※2 詳細は、2019年12月18日付け開示資料「中国における投資計画の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、出資比率は最終的な出資比率であり、出資契約に基づき実施いたします。

業績推移

(百万円)	2013年 12月期	2014年 12月期	2015年 12月期	2016年 12月期	2017年 12月期	2018年 12月期	2019年 12月期	2020年 12月期
売上高	3,475	4,566	5,285	8,864	10,932	25,478	24,501	25,561
売上総利益	1,173	1,820	1,852	2,544	4,252	8,366	7,940	8,681
販管費	471	654	791	958	1,269	2,615	3,223	4,151
営業利益	703	1,166	1,061	1,585	2,982	5,751	4,717	4,530
経常利益	819	1,247	770	1,444	3,159	6,141	5,416	5,252
当期利益 ※	525	664	143	861	2,113	3,620	3,035	2,824
配当金 (円)	-	-	-	10	5	10	15	20
設備投資	338	3,503	4,665	209	95	1,328	4,809	9,610
減価償却 費	87	103	326	682	714	1,298	1,814	1,674
研究開発 費	1	6	11	85	183	501	449	929
従業員数 (正社員) (人)	152	191	265	373	434	1,159	1,277	1,187

※親会社株主に帰属する当期純利益

主要財務諸表

(百万円)	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期
資産の部								
流動資産	1,811	2,759	3,732	5,348	7,388	26,074	32,760	32,626
現金及び預金	397	1,190	1,842	1,952	3,243	14,879	22,156	19,082
受取手形及び売掛金	681	696	795	2,531	2,916	6,958	6,047	6,321
商品及び製品	396	376	361	348	446	1,343	1,713	2,116
固定資産	508	4,064	5,845	5,333	4,843	10,516	15,873	26,124
有形固定資産	461	3,918	5,667	5,152	4,674	8,963	14,635	24,146
無形固定資産	19	15	29	23	19	1,099	732	527
投資その他資産	27	130	148	158	149	453	506	1,451
資産合計	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750
負債の部								
流動負債	960	2,292	2,295	2,993	3,370	4,979	7,252	12,631
支払手形及び買掛金	138	151	186	283	398	1,554	1,614	2,871
有利子負債	136	827	1,216	1,538	1,276	976	1,730	1,522
固定負債	709	2,934	4,798	4,317	3,335	2,474	5,400	5,754
長期借入金	615	2,925	4,079	3,620	2,767	1,848	2,232	1,613
負債合計	1,670	5,227	7,093	7,310	6,705	7,453	12,652	18,385
純資産の部								
純資産	649	1,596	2,483	3,371	5,526	29,137	35,981	40,365
負債・純資産合計	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750

*2013年12月期は単独決算となっております

セグメント別 業績推移

(百万円)	2013年 12月期	2014年 12月期	2015年 12月期	2016年 12月期	2017年 12月期	2018年 12月期	2019年 12月期	2020年 12月期
売上高								
ウェーハ再生事業	3,347	4,414	5,107	7,144	9,487	10,973	10,776	11,461
プライムウェーハ製造販売事業	—	—	—	—	—	11,918	10,058	8,755
半導体生産設備の買収・販売	—	—	—	1,654	1,393	2,918	4,047	6,272
その他、調整額	127	151	178	66	52	△331	△380	△927
セグメント利益								
ウェーハ再生事業	916	1,444	1,377	1,765	3,396	4,011	4,081	4,027
プライムウェーハ製造販売事業	—	—	—	—	—	2,048	1,503	1,041
半導体生産設備の買収・販売	—	—	—	230	130	366	171	211
その他、調整額	△214	△278	△316	△409	△543	△675	△1,038	△749
セグメント資産								
ウェーハ再生事業	1,337	5,040	6,987	5,657	8,120	9,150	10,336	11,698
プライムウェーハ製造販売事業	—	—	—	—	—	21,313	29,311	35,697
半導体生産設備の買収・販売	—	—	—	1,137	1,305	1,939	3,179	5,387
その他、調整額	982	1,783	2,589	3,887	2,805	4,315	5,806	5,968

*2015年、2016年、2017年12月期の決算数値は2019年3月5日にリリースした訂正後の数値となっております

当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性があります。

本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実性を含んでおります。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。